

製品仕様一覧

製品名称		MAGNIA R3320c						
形名		/2403s	/2407s	/2420s	/2430s	/2430Ls	/2440s	/2470s
形番		TN8100-2111T	TN8100-2112T	TN8100-2113T	TN8100-2114T	TN8100-2115T	TN8100-2116T	TN8100-2117T
CPU	搭載 CPU	インテル® Xeon® プロセッサ E5-2403 v2	インテル® Xeon® プロセッサ E5-2407 v2	インテル® Xeon® プロセッサ E5-2420 v2	インテル® Xeon® プロセッサ E5-2430 v2	インテル® Xeon® プロセッサ E5-2430L v2	インテル® Xeon® プロセッサ E5-2440 v2	インテル® Xeon® プロセッサ E5-2470 v2
	動作周波数	1.80GHz	2.40GHz	2.20GHz	2.50GHz	2.40GHz	1.90GHz	2.40GHz
	標準搭載数/最大搭載数	1/2						
	インテル®スマート・キャッシュ (ラスト・レベル・キャッシュ)	10MB		15MB			20MB	25MB
	コア数/スレッド数 (T)(1CPU)	4C/4T		6C/12T			8C/16T	10C/20T
	コントローラー・ハブとの接続	DMI2 4GB/s						
	インテル®バーチャライゼーション・テクノロジー	対応						
	インテル®ハイパー・スレディング・テクノロジー	-		対応				
	インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー	-		対応				
チップセット		インテル® C602 チップセット						
メモリ	搭載容量 標準/最大	標準搭載なし (セレクトラブルオプション) / Unbuffered DIMM 48GB (12x 4GB),Registered DIMM 384GB (12x 32GB).						
	搭載メモリ	DDR3L-1600 Unbuffered DIMM (4GB), DDR3L-1600 Registered DIMM (4/8/16GB), DDR3L-1333 Registered DIMM (32GB)						
	最大動作周波数	1333MHz			1600MHZ			
	誤り検出・訂正	ECC, x4 SDDC, メモリロックステップ (x8 SDDC)						
	メモリスベアリング	対応						
	メモリモラーリング	対応						
補助記憶装置	ドライブベイ	内蔵標準	-					
		内蔵最大	2.5 型 HDD: SATA 16TB (16x 1TB), 2.5 型 HDD: SAS 19.2TB (16x 1.2TB) 2.5 型 SSD: SAS 6.4TB(16x400GB) (オプション HDD ケージ追加時)					
		ホットプラグ	対応					
	インターフェース規格と RAID 構成	SATA 3, 6Gb/s : RAID 0/1/10(標準), RAID 5/6/50/60 (オプション) SAS 6Gb/s : RAID 0/1/5/6/10/50/60 (オプション)						
	光ディスクドライブ	内蔵/外付ドライブ接続 (オプション)						
	FDD	オプション: Flash FDD (1.44MB)						
	拡張ベイ	1x3.5 型拡張ベイ						
	拡張スロット	対応スロット	1x PCI Express 3.0 (x8 レーン, x8 ソケット) (フルハイト, 177mm サイズ) 1x PCI Express 3.0 (x8 レーン, x8 ソケット) (RAID コントローラー専用) 2x PCI Express 3.0 (x4 レーン, x8 ソケット) (ロープロファイル[ブラケットはフルハイト形状], 197mm サイズ) 1x PCI Express 2.0 (x4 レーン, x8 ソケット) (ロープロファイル, 177mm サイズ) 1x PCI Express 2.0 (x1 レーン, x4 ソケット) (ロープロファイル, 177mm サイズ)					
グラフィック	搭載チップ/ビデオ RAM	マネージメントコントローラーチップ内蔵 / 32MB						
	グラフィック表示と解像度	1677 万色: 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024						
標準インターフェース		9x USB2.0 (2x 前面, 4x 背面, 3x 内部), 2x アナログ RGB (ミニ D-Sub15 ピン, 1x 前面, 1x 背面) 1x シリアルポート (RS-232C 規格準拠/D-Sub9 ピン, シリアルポート A, 1x 背面, オプションで計 2 ポートに増設可) 4x 1000BASE-T LAN コネクタ (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 対応, RJ-45, 4x 背面) 1x マネージメント専用 LAN コネクタ (100BASE-TX/10BASE-T 対応, RJ-45, 1x 背面)						
キーボード・マウス		オプション						
冗長電源		対応 (オプション, ホットプラグ可)						
冗長ファン		対応 (オプション, ホットプラグ可)						

外形寸法(幅×奥行き×高さ)		448.4mm × 696.3mm × 87.4mm (フロントベゼル/スライドレール/突起物含まず) 482.0mm × 869.9mm × 88.0mm (フロントベゼル/スライドレール/突起物含む)						
質量(最小/最大)		18kg(1x CPU, 1x DIMM, 1x HDD, 1x 電源ユニット)/29kg (レール含む)						
電源		標準搭載なし(セレクトラブルオプション), AC 電源ユニット(TN8181-86T,87T) 450W/800W 80 PLUS® Platinum 取得電源 (二極並行アース付きコンセント)(ホットプラグ可)(最大:2) AC100V/200V±10%, 50/60Hz±3Hz (電源ケーブルは必須選択オプション) AC 電源ユニット(TN8181-118T) 800W 80 PLUS® Titanium 取得電源 (二極並行アース付きコンセント)(ホットプラグ可)(最大:2) AC200V±10%, 50/60Hz±3Hz (電源ケーブルは必須選択オプション)						
消費電力(100V 最大構成時、25°C、高負荷時)	346VA / 344W	359VA / 356W	412VA / 409W	464VA / 461W	401VA / 398W	476VA / 473W	533VA / 529W	
消費電力(100V 最大構成時、最大電力)	542VA / 538W	548VA / 544W	603VA / 599W	660VA / 655W	587VA / 583W	653VA / 649W	714VA / 709W	
消費電力(200V 最大構成時、25°C、高負荷時)	343VA / 341W	355VA / 353W	408VA / 405W	460VA / 457W	397VA / 394W	472VA / 468W	527VA / 524W	
消費電力(200V 最大構成時、最大電力)	536VA / 532W	542VA / 538W	597VA / 593W	653VA / 648W	581VA / 577W	647VA / 642W	707VA / 702W	
省エネ法(2011 年度基準)に基づくエネルギー消費効率率(W/GTOPS)	1.06(J 区分)	0.802(J 区分)	0.582(J 区分)	0.512(J 区分)	0.548(J 区分)	0.549(J 区分)	対象外	
音量	音圧レベル(100V 最大構成時、高負荷時)	50.2dB						
温度/湿度条件		動作時: 10~40°C/20~80% , 保管時: -10~55°C/20~80% (動作時/保管時ともに結露しないこと)						
主な添付品		EXPRESSBUILDER(ESMPRO/ServerManager(Windows 版), ESMPRO/ServerAgent, ユーザーズガイド(電子マニュアル) 含む), スタートアップガイド, 保証書, ワンタッチラックレール, フロントベゼル						
対応 OS	Windows	Microsoft® Windows Server® 2008 Standard (RTM, SP2 以降) (TN8100-2117T はサポート対象外), Microsoft® Windows Server® 2008 Enterprise (RTM, SP2 以降) (TN8100-2117T はサポート対象外), Microsoft® Windows Server® 2008 Standard (x64) (RTM, SP2 以降), Microsoft® Windows Server® 2008 Enterprise (x64) (RTM, SP2 以降), Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Standard, Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Enterprise, Microsoft® Windows Server® 2012 Standard, Microsoft® Windows Server® 2012 Datacenter, Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Standard, Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Datacenter,						
	Linux	Red Hat® Enterprise Linux® 5.10 以降(x86) (TN8100-2117T はサポート対象外), Red Hat® Enterprise Linux® 5.10 以降(EM64T), Red Hat® Enterprise Linux® Linux 6.5 以降(x86) (TN8100-2117T はサポート対象外), Red Hat® Enterprise Linux® 6.5 以降(x86_64),						
	VMware	VMware ESXi 5.0 Update 3, VMware ESXi 5.1 Update 1, VMware ESXi 5.5						

## 製品環境諸元一覧

国際エネルギー計画基準への適合 (Y/N)	適合予定						
低電力モード消費電力(W)	50.6	52.1	51.0	51.2	50.8	54.8	52.2
グリーン購入法特記事項(2012年2月閣議決定)	適合						
省エネ法関連特記事項	省エネ法基準適合						省エネ法規制対象外*1
リサイクル設計 (Y/N)	Y						
再生プラスチック材料使用	再生プラスチック材の使用 (Y/N)	N					
	使用箇所	-					
リサイクル関連特記事項	25g 以上の本体樹脂部品に材料表示						
取扱説明書における再生紙使用 (Y/N)	- (紙媒体の添付なし)						
特定臭素系難燃剤(PBBs, PBDEs, (PBDEs))の不使用 (Y/N)	Y						
塩ビ(PVC)の不使用 (Y/N)	Y						
梱包材への発泡剤の不使用 (Y/N)	N						
梱包材への PVC の不使用 (Y/N)	Y						

\*1 200GTOPS を超えるため省エネ法(2011 年度目標基準)規制対象外です。

製品仕様一覧

製品名称		MAGNIA R3320c	
形名		/2403e	/2430e
形番		TN8100-2118T	TN8100-2119T
CPU	搭載 CPU	インテル® Xeon® プロセッサ E5-2403 v2	インテル® Xeon® プロセッサ E5-2430 v2
	動作周波数	1.80GHz	2.50GHz
	標準搭載数/最大搭載数	1/2	
	インテル®スマート・キャッシュ (ラスト・レベル・キャッシュ)	10MB	15MB
	コア数®/スレッド数 (T)(1CPU)	4C/4T	6C/12T
	コントローラー・ハブとの接続	DMI2 4GB/s	
	インテル®バーチャライゼーション・テクノロジー	対応	
	インテル®ハイパー・スレッディング・テクノロジー	—	対応
	インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー	—	対応
チップセット		インテル® C602 チップセット	
メモリ	搭載容量 標準/最大	標準搭載なし (セレクトラブルオプション) / Unbuffered DIMM 48GB (12x 4GB),Registered DIMM 384GB (12x 32GB).	
	搭載メモリ	DDR3L-1600 Unbuffered DIMM (4GB), DDR3L-1600 Registered DIMM (4/8/16GB), DDR3L-1333 Registered DIMM (32GB)	
	最大動作周波数	1333MHz	1600MHz
	誤り検出・訂正	ECC, x4 SDDC, メモリロックステップ (x8 SDDC)	
	メモリスベアリング	対応	
	メモリミラーリング	対応	
補助記憶装置	ドライブベイ	内蔵標準	—
		内蔵最大	2.5 型 HDD: SATA 26TB (26x 1TB), SAS 31.2TB (26x 1.2TB), 2.5 型 SSD: SAS 10.4TB (26x 400GB) (オプション HDD ケージ(リア)追加時)
		ホットプラグ	対応
	インターフェース規格と RAID 構成	SATA 3, 6Gb/s : RAID 0/1/10(標準), RAID 5/6/50/60 (オプション) SAS 6Gb/s : RAID 0/1/5/6/10/50/60 (オプション)	
	光ディスクドライブ	外付ドライブ接続 (オプション)	
	FDD	オプション: Flash FDD (1.44MB)	
	拡張ベイ	—	
拡張スロット	対応スロット	1x PCI Express 3.0 (x8 レーン, x8 ソケット) (フルハイト、177mm サイズ)	
		1x PCI Express 3.0 (x8 レーン, x8 ソケット) (RAID コントローラー専用)	
		2x PCI Express 3.0 (x4 レーン, x8 ソケット) (ロープロファイル[ブラケットはフルハイト形状]、197mm サイズ)	
		1x PCI Express 2.0 (x4 レーン, x8 ソケット) (ロープロファイル、177mm サイズ)	
		1x PCI Express 2.0 (x1 レーン, x4 ソケット) (ロープロファイル、177mm サイズ)	
グラフィック	搭載チップ/ビデオ RAM	マネージメントコントローラーチップ内蔵 / 32MB	
	グラフィック表示と解像度	1677 万色: 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024	
標準インターフェース		9x USB2.0 (2x 前面, 4x 背面, 3x 内部), 1x アナログ RGB (ミニ D-Sub15 ピン, 1x 背面) 1x シリアルポート (RS-232C 規格準拠/D-Sub9 ピン, シリアルポート A, 1x 背面, オプションで計 2 ポートに増設可) 4x 1000BASE-T LAN コネクタ (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 対応, RJ-45, 4x 背面) 1x マネージメント専用 LAN コネクタ (100BASE-TX/10BASE-T 対応, RJ-45, 1x 背面)	
キーボード・マウス		オプション	
冗長電源		対応 (オプション, ホットプラグ可)	
冗長ファン		対応 (オプション, ホットプラグ可)	
外形寸法(幅×奥行×高さ)		448.4mm × 696.3mm × 87.4mm (フロントベゼル/スライドレール/突起物含まず)	
		482.0mm × 869.9mm × 88.0mm (フロントベゼル/スライドレール/突起物含む)	

質量(最小/最大)	17kg(1x CPU, 1x DIMM, 1x HDD, 1x 電源ユニット) / 31kg (レール含む)	
電源	標準搭載なし(セレクトラブルオプション), AC 電源ユニット(TN8181-87T) 800W 80 PLUS® Platinum 取得電源 (二極並行アース付きコンセント)(ホットプラグ可) (最大 : 2) AC100V/200V±10%, 50/60Hz±3Hz (電源ケーブルは必須選択オプション) AC 電源ユニット(TN8181-118T) 800W 80 PLUS® Titanium 取得電源 (二極並行アース付きコンセント)(ホットプラグ可) (最大 : 2) AC200V±10%, 50/60Hz±3Hz (電源ケーブルは必須選択オプション)	
消費電力(100V 最大構成時、25°C、高負荷時)	435VA / 432W	494VA / 490W
消費電力(100V 最大構成時、最大電力)	624VA / 620W	677VA / 672W
消費電力(200V 最大構成時、25°C、高負荷時)	431VA / 428W	489VA / 485W
消費電力(200V 最大構成時、最大電力)	618VA / 614W	670VA / 665W
省エネ法(2011 年度基準)に基づくエネルギー消費効率(W/GTOPS)	1.06(J 区分)	0.512(J 区分)
音量	音圧レベル(100V 最大構成時、高負荷時)	56.1dB
温度/湿度条件	動作時: 10~40°C/20~80% , 保管時: -10~55°C/20~80% (動作時/保管時ともに結露しないこと)	
主な添付品	EXPRESSBUILDER(ESMPRO/ServerManager(Windows 版), ESMPRO/ServerAgent, ユーザーズガイド(電子マニュアル) 含む), スタートアップガイド, 保証書, ワンタッチラックレール, フロントベゼル	
対応 OS	Windows	Microsoft® Windows Server® 2008 Standard (RTM, SP2 以降), Microsoft® Windows Server® 2008 Enterprise (RTM, SP2 以降), Microsoft® Windows Server® 2008 Standard (x64) (RTM, SP2 以降), Microsoft® Windows Server® 2008 Enterprise (x64) (RTM, SP2 以降), Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Standard, Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Enterprise, Microsoft® Windows Server® 2012 Standard, Microsoft® Windows Server® 2012 Datacenter, Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Standard, Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Datacenter.
	Linux	Red Hat® Enterprise Linux® 5.10 以降(x86), Red Hat® Enterprise Linux® 5.10 以降(EM64T), Red Hat® Enterprise Linux® Linux 6.5 以降(x86), Red Hat® Enterprise Linux® 6.5 以降(x86_64),
	VMware	VMware ESXi 5.0 Update 3, VMware ESXi 5.1 Update 1, VMware ESXi 5.5

## 製品環境諸元一覧

国際エネルギースター計画基準への適合 (Y/N)	適合予定	
低電力モード消費電力(W)	96.9	93.9
グリーン購入法特記事項(2012 年 2 月閣議決定)	適合	
省エネ法関連特記事項	省エネ法基準適合	
リサイクル設計 (Y/N)	Y	
再生プラスチック材料使用	再生プラスチック材の使用 (Y/N)	N
	使用箇所	-
リサイクル関連特記事項	25g 以上の本体樹脂部品に材料表示	
取扱説明書における再生紙使用 (Y/N)	- (紙媒体の添付なし)	
特定臭素系難燃剤(PBBs, PBDDOs, (PBDEs))の不使用 (Y/N)	Y	
塩ビ(PVC)の不使用 (Y/N)	Y	
梱包材への発泡剤の不使用 (Y/N)	N	
梱包材への PVC の不使用 (Y/N)	Y	

製品仕様一覧

製品名称		MAGNIA R3320c	
形名		/2403i	/2430i
形番		TN8100-2120T	TN8100-2121T
CPU	搭載 CPU	インテル® Xeon® プロセッサ E5-2403 v2	インテル® Xeon® プロセッサ E5-2430 v2
	動作周波数	1.80GHz	2.50GHz
	標準搭載数/最大搭載数	1/2	
	インテル®スマート・キャッシュ (ラスト・レベル・キャッシュ)	10MB	15MB
	コア数®/スレッド数 (T)(1CPU)	4C/4T	6C/12T
	コントローラー・ハブとの接続	DMI2 4GB/s	
	インテル®バーチャライゼーション・テクノロジー	対応	
	インテル®ハイパー・スレディング・テクノロジー	—	対応
	インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー	—	対応
チップセット		インテル® C602 チップセット	
メモリ	搭載容量 標準/最大	標準搭載なし (セレクトラブルオプション) / Unbuffered DIMM 48GB (12x 4GB),Registered DIMM 384GB (12x 32GB).	
	搭載メモリ	DDR3L-1600 Unbuffered DIMM (4GB), DDR3L-1600 Registered DIMM (4/8/16GB), DDR3L-1333 Registered DIMM (32GB)	
	最大動作周波数	1333MHz	1600MHz
	誤り検出・訂正	ECC, x4 SDDC, メモリロックステップ (x8 SDDC)	
	メモリスペアリング	対応	
	メモリミラーリング	対応	
補助記憶装置	ドライブベイ	内蔵標準	—
		内蔵最大	3.5 型 HDD: SATA 48TB (12x 4TB) + 2.5 型 HDD: SATA 2TB (2x 1TB), SAS 2.4TB (2x 1.2TB), 2.5 型 SSD: SAS 800GB (2x 400GB) (オプション HDD ケージ(リア)追加時)
		ホットプラグ	対応
	インターフェース規格と RAID 構成	SATA 3, 6Gb/s : RAID 0/1/10(標準), RAID 5/6/50/60 (オプション) SAS 6Gb/s : RAID 0/1/5/6/10/50/60 (オプション)	
	光ディスクドライブ	外付ドライブ接続 (オプション)	
	FDD	オプション: Flash FDD (1.44MB)	
	拡張ベイ	—	
	拡張スロット	対応スロット	1x PCI Express 3.0 (x8 レーン, x8 ソケット) (フルハイト、177mm サイズ) 1x PCI Express 3.0 (x8 レーン, x8 ソケット) (RAID コントローラー専用) 2x PCI Express 3.0 (x4 レーン, x8 ソケット) (ロープロファイル[ブラケットはフルハイト形状]、197mm サイズ) 1x PCI Express 2.0 (x4 レーン, x8 ソケット) (ロープロファイル、177mm サイズ) 1x PCI Express 2.0 (x1 レーン, x4 ソケット) (ロープロファイル、177mm サイズ)
グラフィック	搭載チップ/ビデオ RAM	マネージメントコントローラーチップ内蔵 / 32MB	
	グラフィック表示と解像度	1677 万色: 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024	
標準インターフェース		9x USB2.0 (2x 前面、4x 背面、3x 内部), 1x アナログ RGB (ミニ D-Sub15 ピン, 1x 背面) 1x シリアルポート (RS-232C 規格準拠/D-Sub9 ピン, シリアルポート A, 1x 背面, オプションで計 2 ポートに増設可) 4x 1000BASE-T LAN コネクタ (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 対応, RJ-45, 4x 背面) 1x マネージメント専用 LAN コネクタ (100BASE-TX/10BASE-T 対応, RJ-45, 1x 背面)	
キーボード・マウス		オプション	
冗長電源		対応 (オプション, ホットプラグ可)	
冗長ファン		対応 (オプション, ホットプラグ可)	

外形寸法(幅×奥行き×高さ)	448.4mm × 696.3mm × 87.4mm (フロントベゼル/スライドレール/突起物含まず) 482.0mm × 869.9mm × 88.0mm (フロントベゼル/スライドレール/突起物含む)	
質量(最小/最大)	17kg(1x CPU, 1x DIMM, 1x HDD, 1x 電源ユニット) / 33kg (レール含む)	
電源	標準搭載なし(セレクトラブルオプション), AC 電源ユニット(TN8181-87T) 800W 80 PLUS® Platinum 取得電源 (二極並行アース付きコンセント)(ホットプラグ可)(最大 : 2) AC100V/200V±10%, 50/60Hz±3Hz (電源ケーブルは必須選択オプション) AC 電源ユニット(TN8181-118T) 800W 80 PLUS® Titanium 取得電源 (二極並行アース付きコンセント)(ホットプラグ可)(最大 : 2) AC200V±10%, 50/60Hz±3Hz (電源ケーブルは必須選択オプション)	
消費電力(100V 最大構成時、25°C、高負荷時)	380VA / 377W	448VA / 445W
消費電力(100V 最大構成時、最大電力)	563VA / 559W	624VA / 619W
消費電力(200V 最大構成時、25°C、高負荷時)	376VA / 374W	443VA / 440W
消費電力(200V 最大構成時、最大電力)	557VA / 553W	618VA / 613W
省エネ法(2011 年度基準)に基づくエネルギー消費効率率(W/GTOPS)	1.06(J 区分)	0.512(J 区分)
音量	音圧レベル(100V 最大構成時、高負荷時)	56.1dB
温度/湿度条件	動作時 : 10~40°C/20~80% , 保管時 : -10~55°C/20~80% (動作時/保管時ともに結露しないこと)	
主な添付品	EXPRESSBUILDER(ESMPRO/ServerManager(Windows 版), ESMPRO/ServerAgent, ユーザーズガイド(電子マニュアル) 含む), スタートアップガイド, 保証書, ワンタッチトラックレール, フロントベゼル	
対応 OS	Windows	Microsoft® Windows Server® 2008 Standard (RTM, SP2 以降), Microsoft® Windows Server® 2008 Enterprise (RTM, SP2 以降), Microsoft® Windows Server® 2008 Standard (x64) (RTM, SP2 以降), Microsoft® Windows Server® 2008 Enterprise (x64) (RTM, SP2 以降), Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Standard, Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Enterprise, Microsoft® Windows Server® 2012 Standard, Microsoft® Windows Server® 2012 Datacenter, Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Standard, Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Datacenter,
	Linux	Red Hat® Enterprise Linux® 5.10 以降(x86), Red Hat® Enterprise Linux® 5.10 以降(EM64T), Red Hat® Enterprise Linux® Linux 6.5 以降(x86), Red Hat® Enterprise Linux® 6.5 以降(x86_64),
	VMware	VMware ESXi 5.0 Update 3, VMware ESXi 5.1 Update 1, VMware ESXi 5.5

## 製品環境諸元一覧

国際エネルギー効率計画基準への適合 (Y/N)	適合予定	
低電力モード消費電力(W)	97.9	95.2
グリーン購入法特記事項(2012 年 2 月閣議決定)	適合	
省エネ法関連特記事項	省エネ法基準適合	
リサイクル設計 (Y/N)	Y	
再生プラスチック材料使用	再生プラスチック材の使用 (Y/N)	N
	使用箇所	-
リサイクル関連特記事項	25g 以上の本体樹脂部品に材料表示	
取扱説明書における再生紙使用 (Y/N)	- (紙媒体の添付なし)	
特定臭素系難燃剤(PBBs, PBDOs, (PBDEs))の不使用 (Y/N)	Y	
塩ビ(PVC)の不使用 (Y/N)	Y	
梱包材への発泡剤の不使用 (Y/N)	N	
梱包材への PVC の不使用 (Y/N)	Y	